



平成23年5月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年7月15日
上場取引所 東

上場会社名 三益半導体工業株式会社
コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>
代表者 (役職名) 取締役社長
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長
定時株主総会開催予定日 平成23年8月26日
有価証券報告書提出予定日 平成23年8月26日
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 中澤 正幸
(氏名) 八高 達郎
TEL 027-372-2011
配当支払開始予定日 平成23年8月29日

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年5月期の業績(平成22年6月1日～平成23年5月31日)

(1) 経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年5月期	59,536	2.2	2,464	△13.9	2,027	75.1	1,018	88.4
22年5月期	58,280	10.8	2,862	4.4	1,157	14.8	540	38.5

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利 益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年5月期	30.41	—	2.0	2.6	4.1
22年5月期	16.15	—	1.1	1.6	4.9

(参考) 持分法投資損益 23年5月期 一百万円 22年5月期 一百万円

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年5月期	74,609	51,485	69.0	1,537.69
22年5月期	79,650	51,278	64.4	1,531.47

(参考) 自己資本 23年5月期 51,485百万円 22年5月期 51,278百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年5月期	9,782	△3,848	△403	20,051
22年5月期	8,712	△2,471	△1,714	14,521

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向	純資産配当 率
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00	803	148.6	1.6
23年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00	803	78.9	1.6
24年5月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 平成24年5月期の配当予想額は未定とさせていただきます。なお、当該理由は添付資料4ページ「1. 経営成績(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載しております。

3. 平成24年5月期の業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

平成24年5月期の業績予想につきましては、現時点において適切な予想値を算定することは困難であるため、本決算発表時においては未定といたしました。なお、当該理由等は、添付資料3ページ「1. 経営成績(1) 経営成績に関する分析 3 次期の見通し」に記載しております。

4. その他

(1) 重要な会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有
② ①以外の変更 : 無

(注)詳細は、添付資料16ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

23年5月期	35,497,183 株	22年5月期	35,497,183 株
--------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

23年5月期	2,014,746 株	22年5月期	2,013,900 株
--------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数

23年5月期	33,482,799 株	22年5月期	33,483,460 株
--------	--------------	--------	--------------

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 経営成績(1)経営成績に関する分析 3 次期の見通し」をご覧ください。

2. 平成24年5月期の業績予想を未定としていることから、平成24年5月期の配当予想額につきましても未定とさせていただきます。配当予想額の開示が可能となった場合には、速やかに開示いたします。

○添付資料の目次

1. 経営成績	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
2. 企業集団の状況	5
3. 経営方針	5
(1) 会社の経営の基本方針	5
(2) 目標とする経営指標	6
(3) 中長期的な会社の経営戦略ならびに対処すべき課題	6
4. 財務諸表	7
(1) 貸借対照表	7
(2) 損益計算書	9
(3) 株主資本等変動計算書	10
(4) キャッシュ・フロー計算書	12
(5) 継続企業の前提に関する注記	13
(6) 重要な会計方針	13
(7) 重要な会計方針の変更	16
(8) 財務諸表に関する注記事項	17
(貸借対照表関係)	17
(損益計算書関係)	18
(株主資本等変動計算書関係)	19
(キャッシュ・フロー計算書関係)	21
(持分法損益等)	21
(関連当事者情報)	21
(税効果会計関係)	23
(退職給付関係)	24
(セグメント情報等)	25
(1株当たり情報)	27
(重要な後発事象)	27
5. その他	27
(1) 役員の異動	27

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①全般の概況

当事業年度におけるわが国経済は、設備投資や輸出に持ち直しの動きが見られ企業収益は改善してきたものの、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響が強く懸念され、景気は先行き不透明な状況となりました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、メモリーをはじめとした半導体デバイス需要は概ね底堅く推移いたしましたが、東日本大震災による影響を受け厳しい事業環境となりました。

このような経営環境の中で当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、生産数量増加への迅速な対応、更にユーザー全般に対する価格見直し交渉など、総力を挙げて粘り強く業績の改善に取り組みました。

この結果、売上高は595億3千6百万円と前期比2.2%の増収となり、営業利益は24億6千4百万円（前期比13.9%減）、経常利益は20億2千7百万円（同75.1%増）、当期純利益は10億1千8百万円（同88.4%増）となりました。

②セグメント別の概況

セグメント別売上高および事業の概況は次のとおりであります。

なお、当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用し、半導体事業部、産商事業部、エンジニアリング事業部の3事業部を報告セグメントといたしました。

セグメント別売上高および構成比

区 分	(参考) 前事業年度 自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日		当事業年度 自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日	
	百万円	%	百万円	%
半 導 体 事 業 部	28,836	48.7	29,610	48.2
産 商 事 業 部	29,408	49.6	29,446	48.0
エンジニアリング事業部	1,009	1.7	2,330	3.8

(注) 上記売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。

半導体事業部

当事業部におきましては、堅調な半導体需要を背景に、主力の300mmウエハーを中心として生産は高水準で推移し、再生ウエハーにつきましても回復基調が鮮明となりましたが、東日本大震災とそれに続いた計画停電等により生産は影響を受けました。

この結果、当事業部の売上高は296億1千万円となりました。

産商事業部

半導体・電子部品関連各社における生産は持ち直し、設備投資にも回復の動きが見られました。こうした状況の下、当事業部は自社開発製品をはじめとする取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は294億4千6百万円となりました。

エンジニアリング事業部

半導体関連各社の設備投資に回復の動きが見られるなか、当事業部は開発部門としての役割に特化しつつ、産商事業部を通じた自社開発製品の販売活動を積極的に展開いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は23億3千万円となりました。

③次期の見通し

今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響が強く懸念されるなど、わが国経済は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、引き続き緩やかな成長が続き、半導体デバイス需要は底堅く推移するものと期待されます。しかしながら、東日本大震災により引き起こされた原発事故に起因する電力不足の影響が懸念され、足下では不透明な状況が続くものと予想されます。

このような経営環境の下、当社といたしましては今後も徹底した合理化による低コスト生産体制の構築に取り組むとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。一方、安全確保と環境保全を経営の重要課題と位置付け、災害に強い事業基盤を再構築するとともに、管理体制の更なる強化を図り、安全・安定操業の継続に努めてまいります。

次期の業績予想につきましては、現時点において適切な予想値を算定することが困難であることから、本決算発表時においては未定とさせていただきます。

なお、業績予想の開示が可能となった場合には、速やかに開示いたします。

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当事業年度末における総資産は、売上債権の減少等により、前事業年度末と比較して50億4千1百万円減少し、746億9百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により52億4千8百万円減少し、231億2千3百万円となりました。純資産合計は、利益剰余金の増加2億1千4百万円等により、514億8千5百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて55億3千万円増加し、200億5千1百万円となりました。

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は97億8千2百万円(前期比10億6千9百万円増)となりました。これは仕入債務の減少82億3百万円があったものの、売上債権の減少92億5千7百万円や減価償却費56億6千4百万円等により資金が増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は38億4千8百万円(前期比13億7千6百万円増)となりました。これは当事業年度に実施した設備投資により取得した有形固定資産の支払36億9千4百万円等があったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は4億3百万円(前期比13億1千万円減)となりました。これは長期借入れによる収入5億円があったものの、配当金の支払額8億2百万円等があったことによるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成20年5月期	平成21年5月期	平成22年5月期	平成23年5月期
自己資本比率 (%)	61.6	81.6	64.4	69.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	86.1	59.1	48.5	41.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	0.1	0.0	0.0	0.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	382.2	469.0	1,811.0	4,591.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

(注2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

(注4) 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(注5) 利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は業績の向上と株主の皆様への利益分配をともに経営の重要課題と位置付けており、経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後の成長へ向けた事業強化のために有効投資いたします。

当期の期末配当金は、先に行いました中間配当金と同額の1株につき12円を予定しております。これにより、当期の年間配当金は前期と同様1株当たり24円となります。

また、次期の年間配当金につきましては、現時点において業績予想値の算定が困難であることから未定とさせていただきます。

なお、配当予想額の開示が可能となった場合には、速やかに開示いたします。

2. 企業集団の状況

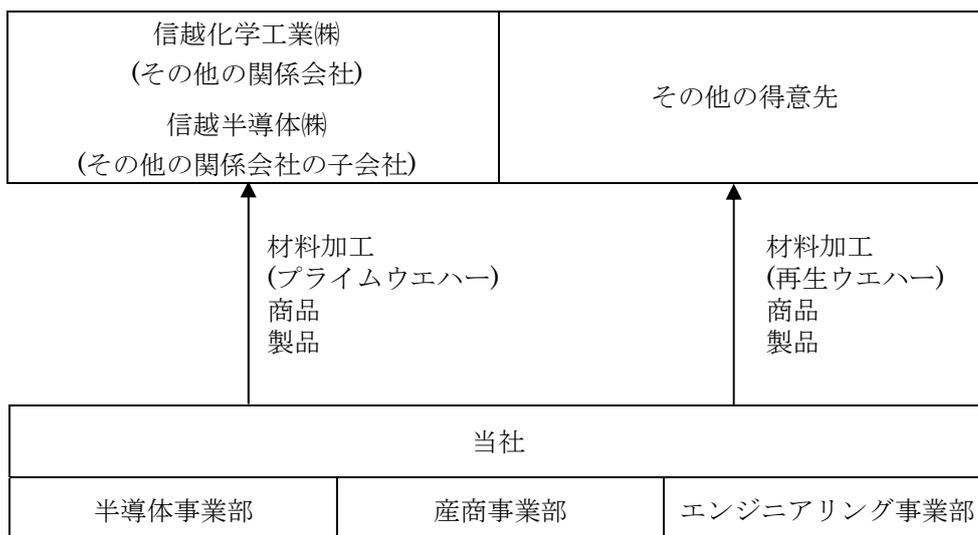
当社の企業集団は、当社、当社のその他の関係会社1社及びその他の関係会社の子会社で構成されております。

当社は、半導体材料の加工、精密機器の販売、自動化装置の設計・製作・販売ならびにこれらに付帯する事業を展開しております。当社の事業は、3事業部からなり、各事業部の主要製・商品は次のとおりであります。

事業部	主要製・商品
半導体事業部	シリコンウエハー(プライムウエハー、再生ウエハー)等
産商事業部	計測器、試験機その他精密機器等
エンジニアリング事業部	半導体材料加工装置、ロボットシステム等の各種自動化装置

主な得意先は、信越半導体(株)であり、半導体事業部におけるプライムウエハー加工は同社より受注しております。

事業の系統図は次のとおりであります。



3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は3事業部がいずれも半導体産業に深く関わりつつ三位一体となって連携し、安全を第一とし、公正な企業活動を行い、業績の向上を図り企業価値を高める株主重視の経営を基本方針としております。

このため、主力の半導体材料加工事業を中心に積極的な事業展開を図るとともに、半導体産業の基礎を支える先端加工技術のたゆまぬ研鑽により高品質・低コストを実現し、経済情勢や市況の変化に的確かつ柔軟に対応できる事業体制の確立を図っております。

(2) 目標とする経営指標

当社は、半導体材料加工事業を軸に、収益の継続的な増大を図りつつ経営効率の改善に努め、総資産経常利益率及び自己資本利益率の向上を図ってまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略ならびに対処すべき課題

当社は、今後とも主力の半導体材料加工事業に経営資源を選択的かつ効果的に投下しながら、全体として景気循環に左右されない強い事業体を目指してまいります。

セグメント別の主な経営戦略と対処すべき課題は以下のとおりであります。

パソコン、デジタル家電、自動車など幅広い分野における半導体デバイス需要を背景として、シリコンウエハーの需要も中長期的に拡大していくことが見込まれております。半導体事業部では、得意とする大口径加工技術を軸として引き続き生産技術及び品質の向上に取り組むとともに、高効率な生産体制を構築して需要拡大に合せた生産能力の増強を推進しQCD S(品質・コスト・納期・サービス)における競争力を高めてまいります。また、安全管理体制を見直し災害に強い事業基盤を再構築するとともに、さまざまなリスクに配慮して安定操業を実現しながら、需要の変化に柔軟に対応できる体制を構築してまいります。当事業部におきましては、こうした施策を着実に実施し、収益の拡大に貢献してまいります。

産商事業部では、特に半導体関連産業の技術動向を迅速に把握しつつユーザーニーズの先取りに努め、引き続きタイムリーかつ機敏な営業活動を展開いたします。また半導体関連以外の産業分野に対しても、市況の変化を的確に捉えながら積極的な営業活動を展開し、特色を生かした安定的な事業基盤を確立してまいります。

エンジニアリング事業部では、開発部門としての役割に特化しつつ他事業部との連携を強化し、特色ある装置開発を展開してまいります。スピンプロセッサ等の自社開発製品について産商事業部と一体となって拡販を進めるとともに、半導体事業部にて使用する製造装置等の開発を積極的に推進することによってウエハー加工事業の競争力強化に貢献するなど、装置開発を通して業績の向上に努めてまいります。

なお、当社は、コンプライアンスやリスク管理及び環境保全など、企業としての社会的責任を果たすべく注力してまいります。また常に地域社会との協調を保ち、それに貢献できるよう対応してまいります。

4. 財務諸表
 (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年5月31日)	当事業年度 (平成23年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,521	20,051
受取手形	201	598
売掛金	27,676	18,021
商品及び製品	111	154
仕掛品	480	374
原材料及び貯蔵品	876	911
前払費用	461	463
繰延税金資産	367	512
その他	395	27
貸倒引当金	△49	△20
流動資産合計	45,045	41,096
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	※1, ※2 16,155	※1, ※2 15,453
構築物(純額)	※2 1,083	982
機械及び装置(純額)	※2 4,641	※2 3,402
車両運搬具(純額)	19	28
工具、器具及び備品(純額)	※2 508	※2 444
土地	3,366	3,363
建設仮勘定	4,691	5,891
有形固定資産合計	30,467	29,567
無形固定資産		
ソフトウェア	※2 644	※2 436
水道施設利用権	1,205	1,058
その他	74	130
無形固定資産合計	1,923	1,625
投資その他の資産		
投資有価証券	191	188
長期前払費用	78	82
繰延税金資産	1,869	1,975
差入保証金	39	38
その他	35	35
投資その他の資産合計	2,214	2,320
固定資産合計	34,605	33,512
資産合計	79,650	74,609

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年5月31日)	当事業年度 (平成23年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	1,449	1,971
買掛金	23,304	14,578
1年内返済予定の長期借入金	50	100
未払金	880	1,188
未払費用	1,154	1,248
未払法人税等	—	1,087
前受金	7	3
預り金	77	52
前受収益	1	1
役員賞与引当金	68	69
災害損失引当金	—	26
設備関係支払手形	—	874
その他	7	—
流動負債合計	26,999	21,201
固定負債		
長期借入金	—	350
退職給付引当金	1,193	1,383
資産除去債務	—	10
その他	179	177
固定負債合計	1,372	1,922
負債合計	28,372	23,123
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金		
資本準備金	18,778	18,778
資本剰余金合計	18,778	18,778
利益剰余金		
利益準備金	689	689
その他利益剰余金		
別途積立金	7,900	7,900
繰越利益剰余金	8,510	8,724
利益剰余金合計	17,099	17,314
自己株式	△3,408	△3,409
株主資本合計	51,293	51,507
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△14	△21
評価・換算差額等合計	△14	△21
純資産合計	51,278	51,485
負債純資産合計	79,650	74,609

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
売上高	58,280	59,536
売上原価	53,038	53,669
売上総利益	5,241	5,867
販売費及び一般管理費	2,378	3,403
営業利益	2,862	2,464
営業外収益		
受取利息	4	4
受取配当金	3	2
その他	20	65
営業外収益合計	28	73
営業外費用		
支払利息	4	2
為替差損	30	71
設備休止費用	※1 1,653	※1 388
その他	45	48
営業外費用合計	1,733	510
経常利益	1,157	2,027
特別利益		
貸倒引当金戻入額	—	29
過年度固定資産税還付金	79	—
その他	12	2
特別利益合計	91	31
特別損失		
固定資産除売却損	※2 22	※2 47
減損損失	※3 159	※3 44
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	9
災害による損失	—	※4 156
特別損失合計	182	257
税引前当期純利益	1,067	1,801
法人税、住民税及び事業税	8	1,028
過年度法人税等	165	—
法人税等調整額	353	△245
法人税等合計	526	782
当期純利益	540	1,018

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	18,824	18,824
当期末残高	18,824	18,824
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	18,778	18,778
当期末残高	18,778	18,778
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	689	689
当期末残高	689	689
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	7,900	7,900
当期末残高	7,900	7,900
繰越利益剰余金		
前期末残高	8,773	8,510
当期変動額		
剰余金の配当	△803	△803
当期純利益	540	1,018
当期変動額合計	△262	214
当期末残高	8,510	8,724
利益剰余金合計		
前期末残高	17,362	17,099
当期変動額		
剰余金の配当	△803	△803
当期純利益	540	1,018
当期変動額合計	△262	214
当期末残高	17,099	17,314
自己株式		
前期末残高	△3,407	△3,408
当期変動額		
自己株式の取得	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0
当期末残高	△3,408	△3,409

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
株主資本合計		
前期末残高	51,556	51,293
当期変動額		
剰余金の配当	△803	△803
当期純利益	540	1,018
自己株式の取得	△0	△0
当期変動額合計	△263	213
当期末残高	51,293	51,507
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△13	△14
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1	△6
当期変動額合計	△1	△6
当期末残高	△14	△21
純資産合計		
前期末残高	51,543	51,278
当期変動額		
剰余金の配当	△803	△803
当期純利益	540	1,018
自己株式の取得	△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1	△6
当期変動額合計	△264	206
当期末残高	51,278	51,485

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	1,067	1,801
減価償却費	6,789	5,664
減損損失	159	44
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3	△29
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	—	26
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	14	1
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△12	190
受取利息及び受取配当金	△8	△7
支払利息	4	2
為替差損益 (△は益)	12	0
有形固定資産除却損	12	7
売上債権の増減額 (△は増加)	△16,065	9,257
たな卸資産の増減額 (△は増加)	9	28
仕入債務の増減額 (△は減少)	17,942	△8,203
その他	△255	704
小計	9,672	9,488
利息及び配当金の受取額	8	7
利息の支払額	△4	△2
法人税等の支払額	△963	△162
法人税等の還付額	—	450
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,712	9,782
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,414	△3,694
有形固定資産の売却による収入	4	15
無形固定資産の取得による支出	△35	△143
投資有価証券の取得による支出	△10	△9
投資有価証券の売却による収入	0	—
その他	△14	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,471	△3,848
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	500
長期借入金の返済による支出	△100	△100
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△802	△802
その他	△810	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,714	△403
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,514	5,530
現金及び現金同等物の期首残高	10,006	14,521
現金及び現金同等物の期末残高	※1 14,521	※1 20,051

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>商品、原材料、貯蔵品ならびに半導体事業部の製品及び仕掛品は、月別総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。 また、エンジニアリング事業部の仕掛品は、個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。</p>	同左
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（改正法人税法に規定する定額法の償却率（1／耐用年数）を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数による均等償却に切り替えて備忘価額1円まで償却する方法）を採用してしております。 なお、平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、残存価額を取得価額の10%とした定率法（旧定率法）によっております。 また、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法（改正法人税法に規定する耐用年数経過時点における残存価額がゼロとなる償却率により、耐用年数にわたって均等に償却する方法）を採用してしております。</p>	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p>

項目	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
	<p>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）のうち、平成19年3月31日以前に取得した建物（建物附属設備は除く）については、残存価額を取得価額の10%とした定額法（旧定額法）によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 8～50年 機械及び装置 3～5年</p> <p>また、通常の使用時間を超えて使用する一部の機械及び装置については、増加償却を実施しております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> <p>その他の無形固定資産 定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。</p> <p>なお、平成20年3月31日以前に契約をした、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	<p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 自社利用のソフトウェア 同左</p> <p>その他の無形固定資産 同左</p> <p>(3) リース資産 同左</p>
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左
5 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支払に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 役員賞与引当金 同左</p>

項目	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
	<p>(3) 災害損失引当金 _____</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、発生事業年度に一括処理しております。 (会計方針の変更) 当事業年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 _____</p>	<p>(3) 災害損失引当金 災害により被災した資産の原状回復等に備えるため、来期以降に発生が見込まれる費用の見積額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左 _____</p> <p>(追加情報) 当事業年度において適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ制度移行するとともに退職給付水準の変更を行いました。 本制度移行及び給付水準の変更に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用したことにより、当事業年度において過去勤務債務236百万円が発生しております。なお、当該過去勤務債務については、当事業年度において一括費用処理しております。 これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ235百万円減少しております。</p>
<p>6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p>	<p>手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資からなっております。</p>	<p>同左</p>
<p>7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>消費税等の会計処理の方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>消費税等の会計処理の方法 同左</p>

(7) 重要な会計方針の変更

(会計方針の変更)

前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
<p>(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更)</p> <p>請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p>	<p>(資産除去債務に関する会計基準等の適用)</p> <p>当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p>

(表示方法の変更)

前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
	<p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において流動負債の「その他」に含めていた「設備関係支払手形」は、負債純資産合計の100分の1を超えたため、当事業年度では区分掲記することとしております。なお、前事業年度の流動負債の「その他」に含まれる「設備関係支払手形」は7百万円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において特別利益の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」は、特別利益総額の100分の10を超えたため、当事業年度では区分掲記することとしております。なお、前事業年度の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は9百万円であります。</p>

(8) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成22年5月31日)	当事業年度 (平成23年5月31日)
※1 国庫補助金による固定資産圧縮記帳額 建物 33百万円	※1 国庫補助金による固定資産圧縮記帳額 建物 33百万円
※2 休止固定資産 固定資産には、以下の休止固定資産(帳簿価額) が含まれております。 有形固定資産	※2 休止固定資産 固定資産には、以下の休止固定資産(帳簿価額) が含まれております。 有形固定資産
建物 784百万円	建物 14百万円
構築物 24	機械及び装置 52
機械及び装置 420	工具、器具及び備品 2
工具、器具及び備品 10	無形固定資産
無形固定資産	ソフトウェア 139
ソフトウェア 209	

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成21年 6月 1日 至 平成22年 5月 31日)	当事業年度 (自 平成22年 6月 1日 至 平成23年 5月 31日)																																																																	
<p>※1 設備休止費用 半導体事業部上郊工場及び足門工場における休止期間中の設備の減価償却費及びリース料であります。</p> <p>※2 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>除却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 建物</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td> 構築物</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td> 工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 撤去費用</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> </tbody> </table> <p>※3 減損損失 当社は、事業用資産について管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っております。 当事業年度においては、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">半導体事業部 足門工場他 (群馬県高崎市)</td> <td rowspan="4">生産用設備</td> <td>建物</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> </tr> </tbody> </table> <p>当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途が定まっていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(建物94百万円、構築物21百万円、機械及び装置41百万円、工具、器具及び備品2百万円)として特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額であり、その評価額は備忘価額としております。</p>	項目	金額(百万円)	除却損		建物	8	構築物	0	機械及び装置	2	工具、器具及び備品	0	撤去費用	10	計	22	場所	用途	種類	半導体事業部 足門工場他 (群馬県高崎市)	生産用設備	建物	構築物	機械及び装置	工具、器具及び備品	<p>※1 設備休止費用 半導体事業部上郊工場及び足門工場における休止期間中の設備の減価償却費及びリース料であります。</p> <p>※2 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>除却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 建物</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td> 構築物</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td> 車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 撤去費用</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>売却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td> 車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">47</td> </tr> </tbody> </table> <p>※3 減損損失 当社は、事業用資産について管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っております。 当事業年度においては、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">半導体事業部 足門工場他 (群馬県高崎市)</td> <td rowspan="5">生産用設備</td> <td>建物</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> </tr> <tr> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途が定まっていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(建物1百万円、構築物2百万円、機械及び装置37百万円、工具、器具及び備品0百万円、土地3百万円)として特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額であり、土地については路線価等を基に算出しており、その他の資産はその評価額を備忘価額としております。</p> <p>※4 災害による損失 東日本大震災による損失額であり、内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>操業休止期間中の固定費</td> <td style="text-align: right;">76百万円</td> </tr> <tr> <td>原状回復費用</td> <td style="text-align: right;">79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額(百万円)	除却損		建物	1	構築物	0	機械及び装置	4	車両運搬具	0	工具、器具及び備品	0	撤去費用	8	売却損		機械及び装置	30	車両運搬具	1	計	47	場所	用途	種類	半導体事業部 足門工場他 (群馬県高崎市)	生産用設備	建物	構築物	機械及び装置	工具、器具及び備品	土地	操業休止期間中の固定費	76百万円	原状回復費用	79	合計	156
項目	金額(百万円)																																																																	
除却損																																																																		
建物	8																																																																	
構築物	0																																																																	
機械及び装置	2																																																																	
工具、器具及び備品	0																																																																	
撤去費用	10																																																																	
計	22																																																																	
場所	用途	種類																																																																
半導体事業部 足門工場他 (群馬県高崎市)	生産用設備	建物																																																																
		構築物																																																																
		機械及び装置																																																																
		工具、器具及び備品																																																																
項目	金額(百万円)																																																																	
除却損																																																																		
建物	1																																																																	
構築物	0																																																																	
機械及び装置	4																																																																	
車両運搬具	0																																																																	
工具、器具及び備品	0																																																																	
撤去費用	8																																																																	
売却損																																																																		
機械及び装置	30																																																																	
車両運搬具	1																																																																	
計	47																																																																	
場所	用途	種類																																																																
半導体事業部 足門工場他 (群馬県高崎市)	生産用設備	建物																																																																
		構築物																																																																
		機械及び装置																																																																
		工具、器具及び備品																																																																
		土地																																																																
操業休止期間中の固定費	76百万円																																																																	
原状回復費用	79																																																																	
合計	156																																																																	

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末
普通株式	35,497,183株	—	—	35,497,183株

2 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末
普通株式	2,013,501株	399株	—	2,013,900株

(注) 当事業年度増加株式数の概要

単元未満株式の買取による自己株式の取得

399株

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

①平成21年8月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	401百万円
1株当たり配当額	12円
基準日	平成21年5月31日
効力発生日	平成21年8月28日

②平成21年12月25日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	401百万円
1株当たり配当額	12円
基準日	平成21年11月30日
効力発生日	平成22年2月3日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成22年8月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	401百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	12円
基準日	平成22年5月31日
効力発生日	平成22年8月27日

当事業年度(自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末
普通株式	35,497,183株	—	—	35,497,183株

2 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末
普通株式	2,013,900株	846株	—	2,014,746株

(注) 当事業年度増加株式数の概要

単元未満株式の買取による自己株式の取得

846株

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

①平成22年8月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	401百万円
1株当たり配当額	12円
基準日	平成22年5月31日
効力発生日	平成22年8月27日

②平成22年12月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	401百万円
1株当たり配当額	12円
基準日	平成22年11月30日
効力発生日	平成23年2月3日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成23年8月26日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

配当金の総額	401百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	12円
基準日	平成23年5月31日
効力発生日	平成23年8月29日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)		当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)	
※1	現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	※1	現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
	現金及び預金勘定 14,521百万円		現金及び預金勘定 20,051百万円
	現金及び現金同等物 14,521		現金及び現金同等物 20,051

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の 関係 会社 の子 会社	信越半導体(株)	東京都 千代田区	10,000	半導体シリ コンの製造 及び販売	(被所有) 直接 1.1	製商品の販 売・半導体 シリコンウ エハー加工 の受託	製商品の販 売・加工料 の売上	26,165	売掛金	7,713

- (注) 1 その他の関係会社は信越化学工業(株)であります。
2 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
3 取引条件及び取引条件の決定方針等
製商品の販売・加工料については、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他 の関係 会社	信越化学工業(株)	東京都 千代田区	119,419	各種化学製 品の製造及 び販売	(被所有) 直接41.0 間接 1.1	半導体材料 等の仕入・ 半導体シリ コンウエハ ー加工の受 託等	半導体材料 等の仕入	18,183	買掛金	7,820

- (注) 1 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
半導体材料等については、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他 の関係 会社 の子会社	信越半導体(株)	東京都 千代田区	10,000	半導体シリ コンの製造 及び販売	(被所有) 直接 1.1	製商品の販 売・半導体 シリコンウ エハー加工 の受託	製商品の販 売・加工料 の売上	26,248	売掛金	6,275

- (注) 1 その他の関係会社は信越化学工業(株)であります。
2 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
3 取引条件及び取引条件の決定方針等
製商品の販売・加工料については、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
<p>1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払賞与 311百万円</p> <p>その他 105</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 417</p> <p>評価性引当額 △32</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 384</p> <p>繰延税金負債 17</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 367</p>	<p>1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払賞与 337百万円</p> <p>未払事業税 91</p> <p>その他 111</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 540</p> <p>評価性引当額 △26</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 513</p> <p>繰延税金負債 0</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 512</p>
<p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>退職給付引当金 482百万円</p> <p>減価償却費 1,335</p> <p>固定資産除却損 108</p> <p>減損損失 196</p> <p>その他有価証券評価差額金 10</p> <p>その他 119</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 2,252</p> <p>評価性引当額 △382</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 1,869</p> <p>繰延税金負債 —</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 1,869</p>	<p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <p>退職給付引当金 559百万円</p> <p>減価償却費 1,379</p> <p>固定資産除却損 100</p> <p>減損損失 191</p> <p>その他有価証券評価差額金 15</p> <p>その他 131</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 2,378</p> <p>評価性引当額 △402</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 1,975</p> <p>繰延税金負債 —</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 1,975</p>
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.4%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金算入されない項目 0.9</p> <p>住民税均等割 0.8</p> <p>役員賞与引当金 2.6</p> <p>評価性引当額の増減 2.5</p> <p>過年度法人税等 2.0</p> <p>その他 0.1</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.3</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.4%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金算入されない項目 0.5</p> <p>役員賞与引当金 1.5</p> <p>評価性引当額の増減 0.8</p> <p>その他 0.3</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5</p>

(退職給付関係)

前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)		当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)	
1	採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。	1	採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けておりましたが、当期において確定給付企業年金制度へ移行しました。
2	退職給付債務に関する事項 退職給付債務 2,515百万円 年金資産 1,322 退職給付引当金 1,193	2	退職給付債務に関する事項 退職給付債務 2,895百万円 年金資産 1,512 退職給付引当金 1,383
3	退職給付費用に関する事項 勤務費用 177百万円 利息費用 45 期待運用収益 △11 数理計算上の差異の処理額 △69 退職給付費用 142	3	退職給付費用に関する事項 勤務費用 172百万円 利息費用 50 期待運用収益 △12 数理計算上の差異の処理額 △24 過去勤務債務の費用処理額 236 退職給付費用 422
4	退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 割引率 2.0% 期待運用収益率 0.96% 数理計算上の差異の処理年数 発生事業年度で一括処理	4	退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 割引率 2.0% 期待運用収益率 0.96% 数理計算上の差異の処理年数 発生事業年度で一括処理 過去勤務債務の額の処理年数 発生事業年度で一括処理

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、「半導体事業部」、「産商事業部」及び「エンジニアリング事業部」の3事業部体制で事業展開を行っており、当該3事業部を報告セグメントとしております。

「半導体事業部」は、プライムウエハーや再生ウエハーなどの半導体材料の加工及び販売を行っております。「産商事業部」は、計測器、試験機その他精密機器等の販売ならびにそれらに付帯する商品及びエンジニアリング事業部による製作品の販売を行っております。「エンジニアリング事業部」は、半導体関連自動化装置等の開発及び設計・製作を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当事業年度(自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	財務諸表 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	29,603	29,446	485	59,536	—	59,536
セグメント間の内部 売上高又は振替高	6	—	1,844	1,851	△1,851	—
計	29,610	29,446	2,330	61,388	△1,851	59,536
セグメント利益	2,313	131	155	2,601	△136	2,464
セグメント資産	39,782	11,474	1,132	52,388	22,220	74,609
その他の項目						
減価償却費	5,633	10	10	5,654	9	5,664
減損損失	44	—	—	44	—	44
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,531	18	4	4,554	12	4,567

(注) 調整額は、以下のとおりであります。

1. セグメント利益の調整額△136百万円は、セグメント間取引消去であります。
2. セグメント資産の調整額22,220百万円は、セグメント間取引消去△934百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産23,155百万円が含まれております。
3. その他の項目の減価償却費の調整額9百万円、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額12百万円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。

(追加情報)

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
1株当たり純資産額 1,531.47円	1株当たり純資産額 1,537.69円
1株当たり当期純利益金額 16.15円	1株当たり当期純利益金額 30.41円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目	前事業年度末 (平成22年5月31日)	当事業年度末 (平成23年5月31日)
純資産額(百万円)	51,278	51,485
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	—	—
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	51,278	51,485
普通株式の発行済株式数(千株)	35,497	35,497
普通株式の自己株式数(千株)	2,013	2,014
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)	33,483	33,482

2 1株当たり当期純利益金額

項目	前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(百万円)	540	1,018
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(百万円)	540	1,018
普通株式の期中平均株式数(千株)	33,483	33,482

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5. その他

(1) 役員の変動

該当事項はありません。